

Express5800/R120h-1Mスペック詳細

フレームモデル

2019/3/26版

製品名称			Express5800/R120h-1M	
モデル名			8x 2.5型ドライブモデル	4x3.5型ドライブモデル
製品型名			N8100-2557Y	N8100-2561Y
CPU	Processor		インテル® Xeon® プロセッサ Bronze 3104(6C/6T, 1.70 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Bronze 3106(8C/8T, 1.70 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4108(8C/16T, 1.80 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4110(8C/16T, 2.10 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4112(4C/8T, 2.60 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Silver 4114(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Silver 4116(12C/24T, 2.10 GHz, 16.50MB, TDP 85W), Gold 5115(10C/20T, 2.40 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 5118(12C/24T, 2.30 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 5120(14C/28T, 2.20 GHz, 19.25MB, TDP 105W), Gold 5122(4C/8T, 3.60 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 6126(12C/24T, 2.60 GHz, 19.25MB, TDP 125W), Gold 6128(6C/12T, 3.40 GHz, 19.25MB, TDP 115W), Gold 6130(16C/32T, 2.10 GHz, 22MB, TDP 125W), Gold 6132(14C/28T, 2.60 GHz, 19.25MB, TDP 140W), Gold 6134(8C/16T, 3.20 GHz, 24.75MB, TDP 130W), Gold 6136(12C/24T, 3 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6138(20C/40T, 2GHz, 27.50MB, TDP 125W), Gold 6140(18C/36T, 2.30 GHz, 24.75MB, TDP 140W), Gold 6142(16C/32T, 2.60 GHz, 22MB, TDP 150W), Gold 6144(8C/16T, 3.50 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6146(12C/24T, 3.20 GHz, 24.75MB, TDP 165W), Gold 6148(20C/40T, 2.40 GHz, 27.50MB, TDP 150W), Gold 6150(18C/36T, 2.70 GHz, 24.75MB, TDP 165W), Gold 6152(22C/44T, 2.10 GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6154(18C/36T, 3GHz, 24.75MB, TDP 200W), Platinum 8153(16C/32T, 2 GHz, 22MB, TDP 125W), Platinum 8156(4C/8T, 3.60 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Platinum 8158(12C/24T, 3GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8160(24C/48T, 2.10 GHz, 33MB, TDP 150W), Platinum 8164(26C/52T, 2GHz, 35.75MB, TDP 150W), Platinum 8168(24C/48T, 2.70 GHz, 33MB, TDP 205W), Platinum 8170(26C/52T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8176(28C/56T, 2.10 GHz, 38.50MB, TDP 165W), Platinum 8180(28C/56T, 2.50 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 6134M(8C/16T, 3.20GHz, 24.75MB, TDP 130W), Platinum 8180M(28C/56T, 2.50 GHz, 38.50MB, TDP 205W)	
		標準搭載数 / 最大搭載数	0/2	
		コントローラ・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)	
		インテル® 64	対応	
		インテル® バーチャライゼーション・テクノロジ	対応	
		インテル® ハイパースレッディング・テクノロジ	対応 (Xeon Bronze 3104/3106は除く)	
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ	対応 (Xeon Bronze 3104/3106は除く)	
		CPUソケット形状	LGA3647	
ホットプラグ	-			
冷却方式	ファンなしヒートシンク			
チップセット	インテル® C621 チップセット			
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB)		
	メモリソケット数	24		
	増設単位	1		
	搭載メモリ	DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB)		
	最大動作周波数	2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)		
	メモリバス帯域(チャンネルあたり)	21.3GB/s		
	メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方式/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)		
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC		
	メモリスベアリング	対応		
	メモリミラーリング	対応		
	ホットプラグ	-		
モジュールピン数	288 ピン			
動作電圧	1.2V			
バッファ機能	対応			
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ
		内蔵標準	リア	2x2.5型増設ドライブ(オプション)
			内部	4x3.5型ドライブ
			1x2.5型ドライブ(オプション)	
		2x M.2 SATAスロット (オプション)		
	内蔵最大	2.5型HDD: SATA 22TB (11x 2TB), SAS 26.4TB (11x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 42.24TB (11x 3.84TB), SAS SSD: 21.12TB (11x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)		
	ホットスワップ	対応		
	インタフェース規格とRAID構成	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)		
光ディスクドライブ	内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1			
FDD	オプション: Flash FDD (1.44MB) *2			
拡張ベイ				
拡張スロット	対応スロット	標準構成 1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、ハーフレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (ロープロファイル、ハーフレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (LOMカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)		
	規格	PCI Express 1.1, 2.0, 3.0		
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB		
標準インタフェース	フロント	640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200 1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用), 1xUSB2.0(Type A)/(N8117-03内蔵DVDドライブ増設キット 搭載時) 2x USB3.0 (TypeA) , 1xアナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 4x データLANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 (RJ-45)) 1x シリアルポート (オプション)		
	リア	2x USB3.0 (TypeA), 1x SATA 2.0 Port		
	内部	オンボード		
ネットワーク	実装形式	オンボード		
	コントローラ	1x Broadcom® BCM5719		
	チームング	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)		
	FEC / GEC	対応		
リモートマネージメント	ジャンボフレーム	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)		
	PXE / iSCSI プート	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応		
	コントローラ	BMC		
マネージメント	マネージメント用ポート	Marvell PHY		
WHvEA(Windows Hardware Error Architecture)			対応	
キーボード / マウス			オプション	
BIOS Version (出荷当初)			System ROM U32 v1.00 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)	
BMC Firmware Revision (出荷当初)			01.10 (最新のリリースはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)	
System Sleep State			S0, S5	
冗長電源			対応 (オプション, ホットプラグ可)	
冗長ファン			対応 (標準, ホットプラグ可)	
筐体デザイン			1Uラックマウント	
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)			434.6mm x 707.0mm x 42.9mm (2.5 型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず) 434.6mm x 749.8mm x 42.9mm (3.5 型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず)	
質量 (最小 / 最大)			14kg / 26kg (ケーブルアーム無し : 22kg)	
			14kg / 29kg (ケーブルアーム無し : 25kg)	
電源			選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-159, 160) 500W/800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161, 162) 800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) DC電源ユニット(N8181-163) 800W DC-48V電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) (電源ケーブルは必須選択オプション) *10	
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)			908VA / 899W (800W 電源最大値) *7	
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)			943VA / 942W *7	
発熱量			3644KJ/h	
省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率			対象外	
音量			35.9dBA / 45.1dBA	
音圧レベル (待機時 / 高負荷時) *4			ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床上: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床上: 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10~35℃(条件付きで5~40℃/45℃対応可) *11, 保管時: 30~60℃ 動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)	
測定方式			VCCI クラス A	
OS認証			Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware	
主な添付品			スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル	
無償保証内容			3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年バージョン保証	
インストールOS			-	
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard*12、Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter*12、Red Hat® Enterprise Linux® 6.9以降 *5 *9 Red Hat® Enterprise Linux® 7.3以降 *5, VMware ESXi™ 6.0 Update3, VMware ESXi™ 6.5 Update1 以降, VMware ESXi™ 6.7		
		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います		
動作確認OS *6			-	

SelectionPack

製品名称				ExpressSelectionPack			
モデル名				8x 2.5型ドライブモデル			
製品型名				NP8100-2557YP1Y		NP8100-2557YP2Y	
CPU	Processor			Silver 4114(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W)			
コントローラ・ハブとの接続			DMI3 (8GB/s)				
インテル® 64			対応				
インテル® バーチャライゼーション・テクノロジ			対応				
インテル® ハイバースレッチング・テクノロジ			対応				
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ			対応				
CPUソケット形状			LGA3647				
ホットプラグ			-				
冷却方式			ファンなしヒートシンク				
チップセット				インテル® C621 チップセット		標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB)	
メモリ	搭載容量 標準 / 最大			24			
	メモリソケット数			1			
	増設単位			DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB)			
	搭載メモリ			2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)			
	最大動作周波数			19.2GB/s			
	メモリバス帯域/(チャネルあたり)			インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)			
	メモリアクセス方式			ECC, x4 SDDC			
	誤り検出・訂正			対応			
	メモリスベアリング			対応			
	メモリマラーリング			-			
	ホットプラグ			288 ピン			
	モジュールピン数			1.2V			
動作電圧			対応				
バッファ機能			8x2.5型ドライブ				
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント	2x2.5型増設ドライブ(オプション)			
			リア	1x2.5型ドライブ(オプション)			
		内蔵標準	内部	2x M.2 SATAスロット (オプション)			
			-				
		内蔵最大	2.5型HDD: SATA 22TB (11x 2TB), SAS 26.4TB (11x 2.4TB)				
			2.5型SSD: SATA 42.24TB (11x 3.84TB), SAS SSD: 21.12TB (11x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)				
	ホットスワップ			対応			
	インタフェース規格とRAID構成			SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)			
	光ディスクドライブ			内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1			
	FDD			オプション: Flash FDD (1.44MB) *2			
	拡張ベイ			-			
	拡張スロット	対応スロット	標準構成				
1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、ハーフレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (ロープロファイル、ハーフレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (LOMカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)							
規格		PCI Express 1.1, 2.0, 3.0					
搭載チップ / ビデオRAM		マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB					
グラフィック表示 と 解像度		640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200					
標準インタフェース	フロント	1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用), 1xUSB2.0(Type A)(N8117-03内蔵DVDドライブ増設キット 搭載時)					
	リア	2x USB3.0 (TypeA) , 1xアナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 4x データLANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 (RJ-45)) 1x シリアルポート (オプション) 2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 2.0 Port					
ネットワーク	内部	オンボード					
	実装形式	1x Broadcom® BCM5719					
	コントローラ	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)					
	チーミング	対応					
	FEC / GEC	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)					
	ジャンボフレーム	PXIE ブート: 対応, iSCSI ブート: 非対応					
リモートマネージメント	コントローラ	BMC					
マネージメント		マネージメント用ポート					
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)		Marvell PHY					
キーボード / マウス		対応					
BIOS Version (出荷当初)		オプション					
BMC Firmware Revision (出荷当初)		System ROM U32 v1.00 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)					
System Sleep State		01.10 (最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)					
冗長電源		S0, S5					
冗長ファン		対応 (オプション, ホットプラグ可)					
筐体デザイン		対応 (標準, ホットプラグ可)					
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)		1Uラックマウント					
質量 (最小 / 最大)		434.6mm x 707.0mm x 42.9mm (2.5 型ドライブモデル: フロントベゼル/レール/突起物含まず) 434.6mm x 749.8mm x 42.9mm (3.5 型ドライブモデル: フロントベゼル/レール/突起物含まず)					
		14kg / 26kg (ケーブルアーム無し: 22kg)					
電源	選択必須オプション						
	AC電源ユニット(N8181-159, 160)						
	500W/800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2)						
	AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)						
	AC電源ユニット(N8181-161, 162)						
	800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2)						
		AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)					
		DC電源ユニット(N8181-163)					
		800W DC-48V 電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) (電源ケーブルは必須選択オプション)					
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		別紙参照					
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		別紙参照					
発熱量		別紙参照					
省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率		対象外					
音量	音圧レベル (待機時 / 高負荷時) *4	35.9dBA / 45.1dBA					
測定方式		ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床上: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床上: 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10~35℃(条件付きで5~40℃/45℃対応可) *11, 保管時: -30~60℃ 動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)					
温度条件							
湿度条件							
ハードウェア認証規定		VCCI クラス A					
OS認証		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware					
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル					
無償保証内容		3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年パーツ保証					
インストールOS		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard *8	Microsoft® Windows Server® 2016 Standard				
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter 、 Microsoft® Windows Server® 2019 Standard*12、Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter*12					
動作確認OS *6		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います					

注意事項

拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで, ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで, MD2 = 167.6mmまでを示します

注釈

- *1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。
- *2 必要に応じて手配してください。主な用途については「Flash FDD製品概要と利用ケース」の構成ガイドを参照下さい。
- *3 VMware ESXi 6.0をインストールした場合、USB2.0で動作します。
- *4 特定構成(2xCPU(Xeon Gold 5118), 2x16GB DIMM, 1xRAIDコントローラ, 1xフレキシブルLOM, 標準ファン, 2x800W電源)での騒音値
- *5 サポートサービスの提供を受けるにはNECよりLinuxサービスセットの購入が必要です。同一メジャーバージョン内での対応となります。
- *6 BTOインストール不可。NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照します。
- *7 CPU TDPごとの最大電力は8.1.2をご参照ください。
- *8 本製品はお客様から提供を要求されている場合に限り、お客様へ販売することが認められています。ご購入の際には、事前にお客様より Windows Server 2016のライセンス条項に同意していただく必要があります。
詳細は<http://jpn.nec.com/windowsserver/2016/down.html> をご覧ください。
- *9 省電力のためのCPU周波数制御においては、HW自動制御の設定が本装置の標準仕様ですが、RHEL6ではCPU周波数制御は未サポートとなります。
- *10 DC-48V電源のほかにDC380V電源を本装置で活用されたい方は、弊社営業まで別途お問い合わせください。
- *11 40℃/45℃環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細は「リファレンス」の「40℃/45℃対応についての注意事項」をご参照ください。
- *12 Windows Server 2019は2019年1月31日より対応予定